

以领航技术
铸格物品质

领格新材料(苏州)有限公司

地址:江苏省苏州市张家港保税区科技创业园B幢318室
Address: Room 318, Building B, Technology Entrepreneurship Park
Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province.
企业邮箱 Email: lingenotech@gmail.com

领格新材料(苏州)有限公司



DNA级的树脂定制能力



MOLELINKER

公司简介 Company Profile

领格新材料成立于2023年,坐落于苏州张家港保税区,是一家深耕高端电子专用材料研发与生产的科技创新型企业。我们致力于于为半导体及新能源、消费电子及光电通讯等领域提供核心材料解决方案。

Lingene New Materials, founded in 2023 and located in the Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, is a tech-innovation enterprise specializing in the R&D and manufacturing of high-end electronic specialty materials. We are dedicated to providing core material solutions for semiconductors, new energy, consumer electronics, and optical communications.

创始人简介 Founder Profile

张辉

中科院材料科学工学博士;
曾担任汉高中国 Ablest®kLOCT®TE产品开发科学家;
负责为Appl®、Samsun®、Huawei®和Xia®mi等全球行业领军企业开发电子结构胶解决方案。

Zhang Hui (Ph.D.)

Ph.D. in Materials Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences (CAS).
Former Product Development Scientist for Ablest®k and LOCT®TE at Henk®l China.
Lead Scientist responsible for the development of electronic structural adhesive solutions for global industry leaders, including Appl®, Samsun®, Huawei® and Xia®mi.

创始人核心项目履历

一、光通讯领域 打破技术垄断,实现微米级精密封装

曾主导研发HHD4*42等环氧/丙烯酸酯双重固化体系。针对光通讯20年长寿命需求,攻克了PEI基材高粘接力、极低收缩率及微米级位移控制等核心难题。该技术突破成功应用于海信光通讯等有源光模块(TO-CAN, Tri-OSA)封装,填补了国内高端光通讯结构胶空白。

二、消费电子 助力顶级品牌实现产值飞跃与工艺迭代

负责Appl®、HUAWE®、SAMSUN®、AMAZ®N、FACEBO®K、XIA®MI,等头部企业封装项目。针对iPh®ne结构件开胶痛点,定制研发了满足20项严苛指标的玻璃盖板结构胶,助力客户实现年销售额6亿元增长。通过提供从表面促进剂到填缝胶的全链路解决方案,显著提升了产品韧性 with 可靠性,帮助客户优化工艺并大幅降低运营成本。

三、柔性显示与前沿应用 深度定制化研发能力

具备敏锐的原材料应用前瞻性,为SAMSUN®OLED/LCD模组量身定制ECCOBOND EN 3410柔性密封胶,解决微图案FPC基板的开裂与分层难题。凭借深厚的配方经验,曾组建并带领乐泰研发团队,实现了从基础原材料理解到高性能定制方案的闭环,持续为全球知名互联网及通讯大厂提供核心胶粘技术支持。

领格技术力量

Strength & Honors

公司及创始人自有技术专利40余项；
领导团队及参与开发国内外知名品牌项目20余项；
2024年第二批张家港市领军型创业创新人才（团队）引进计划。

40+ Proprietary Patents
20+ Global Brand Projects
Leading Talent Awarded Government Recognition.

公司核心技术优势

- 对标国际巨头
具备与日本合*化学、大阪*机、DEL* 等顶尖企业同等的底层树脂合成能力。
- 技术深度
通过自主合成单体与低聚物，我们可以从分子层面调整折射率(高透明度和低双折射)、收缩率(低应力和低收缩)和耐温性(长期可靠性)，彻底解决“卡脖子”原材料依赖。
- 确定性交付
我们的方案不是实验室的理论，而是经过Appl*、SAMSUN*、海x等全球顶级供应链数亿次量产验证的成熟工艺。
- 快速响应
相比外资巨头3-6个月的反馈周期，我们提供24小时响应、7天样品交付的极速服务。

业务领域	已平替项目	对标企业
光通讯	插芯固化、光路耦合、FAU阵列头胶/尾胶	对标N*T、汉G、DEL*；已通过中际*创等测试
汽车LIDAR	棱镜角度定位(<0.05°偏移)、低挥发、车规级可靠性	在激光雷达核心光学组件实现稳定应用
先进封装	3D传感模组AA调焦、芯片固晶、底填胶	满足微米级收缩率要求，支撑高频高速传输
■ 降本路径	通过全产业链(从合成树脂到成品胶水)垂直整合，在不牺牲性能的前提下，帮助客户实现20%-40%的原材料降本。	

应用领域

Applications

01 粘接材料

Adhesives



02 导电材料

Conductive



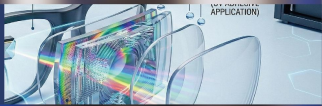
03 密封材料

Encapsulants



04 导热材料

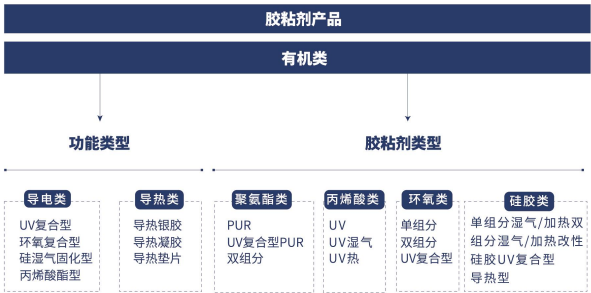
Thermal



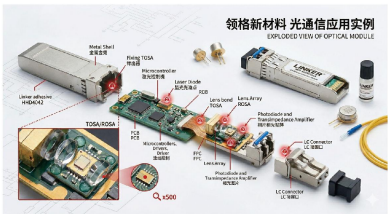
产品介绍

Product Introduction

专注“高附加值、进口替代”的电子级胶粘剂
UV-湿气双固化、低温快速固化环氧、导电银胶、PUR热熔胶四大平台
商业模式:材料销售+应用验证服务+定制化开发(CDMO)

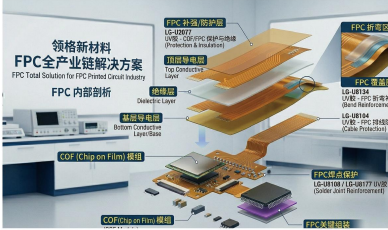


Optical Communications Industry 光通信行业上的应用



应用节点	产品牌号	产品特性与功能
耦合胶	LG-UE1620	UV环氧胶, 具备极低的固化收缩率和卓越的粘接强度, 专为光组件精密耦合设计, 确保光学链路的长效对准稳定性。
粘接胶	LG-E3612	高性能环氧胶, 具备优异的耐候性与物理强度, 适用于光模块内部组件的高强度结构粘接。
尾纤固定胶	LG-UE1602	UV环氧胶, 快速固化且具备良好的韧性, 能有效缓冲光纤尾纤处的机械应力, 防止信号衰减。
导热胶	LG-HC3691	高导热电子级胶粘剂, 提供高效的热管理通道, 协助高功率芯片散热, 保障光模块在高温工况下的传输性能。

Flexible Printed Circuit FPC柔性电路板的应用



应用节点	产品牌号	产品特性与功能
FPC 补强/防护	LG-U2077	UV胶, 专用于COF/FPC的保护, 具备极佳的电气绝缘性和柔韧性, 能有效防止弯折过程中的线路断裂及湿气侵蚀。
FPC 零件补强	LG-U8134	UV胶, 适用于FPC折弯处的补强, 高粘接力且固化后保持一定的弹性, 确保在极端弯折测试下不脱胶、不损伤基材。
FPC 焊点保护	LG-U8108 LG-U8177	UV胶, 快速固化, 能为FPC上的焊点提供机械加固和防腐蚀保护, 提升整体模组的耐用性。
FPC 排线防护	LG-U8104	UV胶, 专为排线防护设计, 具备低收缩率, 避免因固化应力导致薄膜变形。
FPC 关键组装	LG-PU18BK	PUR热熔胶, 100%固含量, 具备卓越的结构粘接强度, 用于 FPC 与框架或其他电子元件的粘接。



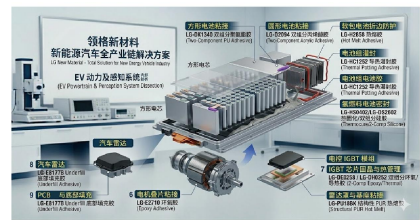
手机电子设备行业上的应用 Mobile & Handheld Electronics

应用节点	产品牌号	产品特性与功能
摄像头AA制程	LG-UE3612	UV环氧胶,专为手机摄像头AA制程设计,具备极低的收缩率和高Tg点,确保光学镜头组与感光芯片的亚微米级精准对齐。
中框结构粘接	LG-H4826 LG-PU18BK	PUR热熔胶,高粘接强度与极细脱路控制,适用于手机TP屏与中框、装饰件的高强度结构粘接,具备优异的抗跌落和耐环境性能。
指纹/屏下模组补强	LG-E8177B	底部填充环氧胶,极佳的流动性与高粘接强度,能快速渗透至芯片底部,提升封装模组的机械抗冲击性。
屏下散热管理	LG-HC0479	高导热电子级胶黏剂。专门应对高性能手机芯片的散热需求,建立高效导热路径,保障设备在高负载下的传输稳定性。
内部焊点防护	LG-U8108 LG-U8177	UV胶,快速固化,具有优异的防潮、耐腐蚀特性,为PCBA上的微小焊点提供长期可靠的机械加固。

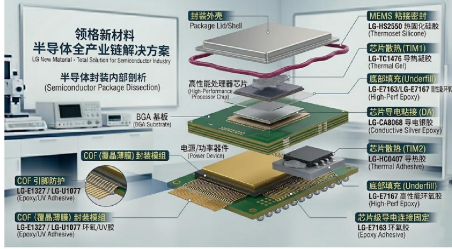


EV汽车行业上的应用 Electric Vehicles

应用节点	产品牌号	产品特性与功能
动力电池粘接	LG-DK1340 LG-D2094	分别为双组分聚氨酯胶(方形电池)及双组分丙烯酸(圆形电池)胶黏剂。提供极高的结构剪切强度,适应不同形态电池的组装需求。
电控IGBT模组	LG-DE0258 LG-DH0252	双组分环氧/导热胶。专为IGBT功率模块设计,提供高电压下的绝缘保护与极速导热路径,防止热失控。
驱动电机组装	LG-E2710	环氧胶,专用于电机硅钢叠片粘接,具备优异的耐湿性和结构强度,能有效抑制高速运转下的噪音与震动。
微型镜头光组件对齐	LG-UE1620	UV环氧胶(低收缩),专用于激光雷达(LiDAR)中的光学耦合,极低的固化收缩率确保发射/接收模组的微米级对准精度。

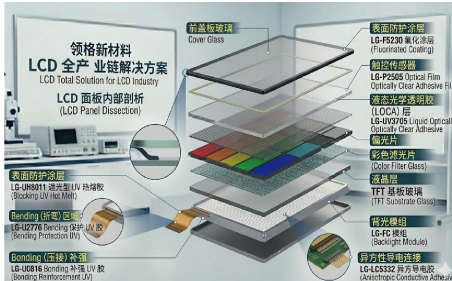


Semiconductor Industry 半导体产业应用



应用节点	产品牌号	产品特性与功能
底部填充	LG-E7163 LG-E7167	高性能环氧胶,具备极佳的流动性,能快速填充BGA/CSP芯片底部,固化后形成强力支撑,显著提升焊点抗机械冲击和热循环应力的能力。
芯片导电粘接	LG-C3181 LG-CA8068	导电银胶,专用于芯片与基板的电气连接,具备极低的体积电阻率和优异的导热性,确保信号传输稳定并辅助散热。
芯片散热	LG-HC0407 LG-TC1476	导热胶/导热凝胶,高填料填充技术,为高性能处理器及功率器件提供极低的热阻界面,保障芯片在高负载下的算力稳定性。
COF封装与防护	LG-E1327 LG-U1077	环氧胶/UV胶,专为薄膜晶圆(COF)设计,具备高纯度、低离子含量,为精细引脚提供卓越的绝缘防护和防潮性能。
芯片导电连接固定	LG-E7163	环氧胶,用于芯片级导电连接后的机械固定,确保在后续工艺中结构位置的纳米级精准。

LCD & Display Technology LCD行业上的应用

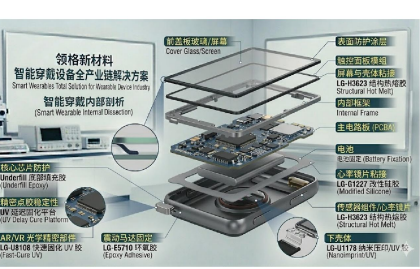


应用节点	产品牌号	产品特性与功能
屏幕贴合	LG-UV3705 LG-P2505	液态光学透明胶(LOCA)/贴合胶膜。具备极高的透光率、低收缩率及优异的耐黄变性能,确保显示画面的纯净度,有效吸收贴合应力。
Bending (折弯) 保护	LG-U2776	UV胶,专为OLED/LCD的Bending区域设计,具备极佳的柔韧性和伸展率,防止线路在折弯过程中因疲劳而断裂。
Bonding (压接) 补强	LG-U0816	UV胶,用于Bonding区域的机械补强,增强连接处的抗拉拔力,保护精细引脚不受外界环境侵蚀。
封边防漏光 (Side Sealing)	LG-UH8011	遮光型UV热熔胶,专用于屏幕侧边封边,兼具遮光(防漏光)与结构粘接功能,满足超窄边框的设计需求。
异方性导电连接固定	LG-LC5332	异方性导电胶,用于PCB与面板之间的导电连接与物理固定,确保电信号的高速稳定传输。
三防/表面防护	LG-F5230	氟化涂层,提供卓越的疏水疏油及耐盐雾保护,常用于高端显示模组的表面或关键器件防护。



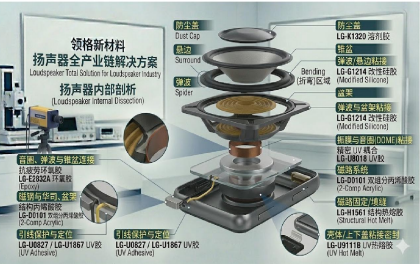
穿戴设备的应用 Wearable Devices

应用节点	产品牌号	产品特性与功能
屏幕与壳体粘接	LG-H3623	结构热熔胶,专用于智能手表/手环的装饰件及屏幕与下壳粘接,具备优异的窄边框粘接强度和抗跌落性能。
心率镜片粘接	LG-H3623	结构热熔胶,适用于心率感应镜片与壳体的粘接密封,确保传感器数据的准确性并提供可靠的防水保护。
电池固定	LG-G1227	改性硅胶,用于电池与壳体间的弹性粘接,提供卓越的抗重缓冲能力,且具备良好的热稳定性。
精密光学粘接	LG-U1178	纳米压印/UV胶,专为AR/VR等设备的光学精密部件设计,具备高透光率和极低收缩率,确保光学路径的精确性。
微型马达组装	LG-E5710	环氧胶,专用于震动马达的固定粘接,耐疲劳强度高,能承受穿戴设备频繁震动带来的机械应力。
核心芯片防护	LG-E8177B	底部填充环氧,具备极佳的渗透力,用于板级芯片加固,防止在跌落或碰撞中出现焊点脱落。



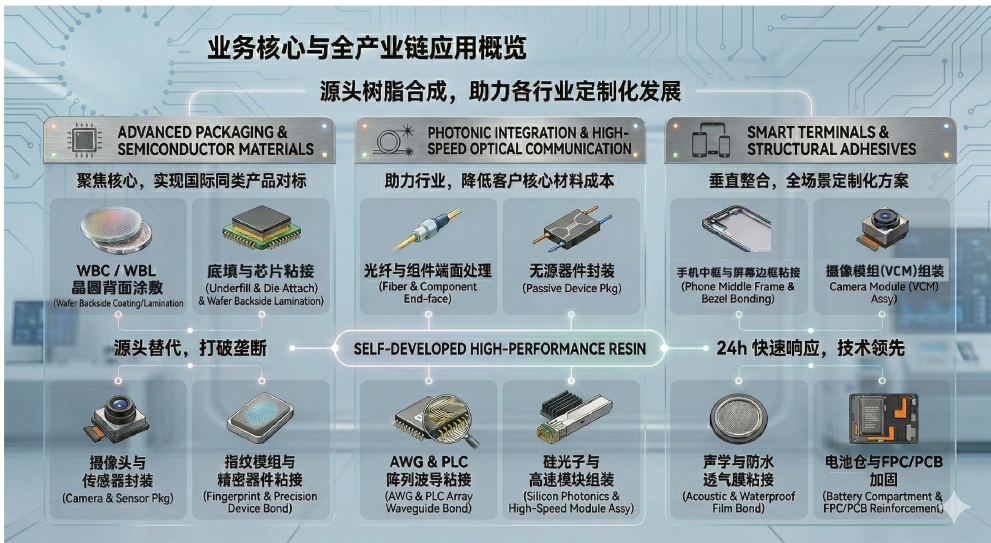
扬声器产业应用 Speaker & Acoustic Industry

应用节点	产品牌号	产品特性与功能
磁路系统粘接	LG-D0101	双组分丙烯酸酯胶,专用于磁轭与华司、盆架的粘接,具备极高的抗剪切强度和耐温稳定性。
磁路固定/填缝	LG-H1561	结构热熔胶,用于磁路和盆架的固定与间隙填充,固化快,能有效抑制漏磁及杂音。
振动系统粘接	LG-U8018	UV胶,用于振膜与音圈(DOME)的粘接,胶层轻薄且强度高,不影响声学频率响应,固化迅速。
中心三点粘接	LG-E2832A	环氧胶,专用于音圈、弹波与锥盆的连接,具备优异的抗疲劳性能,确保大动态下的机械稳定性。
弹波与盆架粘接	LG-G1214	改性硅胶,提供卓越的柔韧性 with 应力缓冲,确保长期震动工况下不脱落。
壳体/上下盖粘接	LG-U9111B	UV热熔胶,用于Speaker上下盖粘接密封,具备优异的密封性,防止漏音并增强整体结构强度。

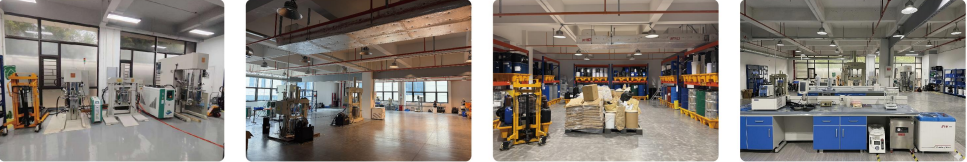


全产业链整合

Integrated R&D and Manufacturing Ecosystem



公司概况
Company Profile



公司部分专利技术



客户群体
Clients



我们寻求一个最难、最头疼的痛点项目, 给我们一次验证机会
让数据证明我们如何超越行业标准

Challenging the Industry Limits
Request for Your Most Demanding Project: Let Data Prove Our Superiority